

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年3月29日(2012.3.29)

【公表番号】特表2011-517113(P2011-517113A)

【公表日】平成23年5月26日(2011.5.26)

【年通号数】公開・登録公報2011-021

【出願番号】特願2011-504022(P2011-504022)

【国際特許分類】

H 01 L 23/50 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/50	U
H 01 L 23/50	R
H 01 L 23/50	H

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月13日(2012.2.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

上側表面(34)、下側表面(36)及び側壁(38)を有するダイパッド(30)において、前記ダイパッド(30)が、前記上側表面(34)に前記側壁(38)に沿って形成される第1の窪み群(42)と、及び、前記下側表面(36)に前記側壁(38)に沿って形成される第2の窪み群(44)とを備える、前記ダイパッド(30)と、

前記ダイパッド(30)の周りに配置されるリード群(32)と、  
を備える、パッケージ化電子デバイス(20)用リードフレーム(22)。

【請求項2】

前記ダイパッド(30)は一定の厚さ(46)を有し、

前記第1の窪み群(42)は前記ダイパッド(30)内に前記上側表面(34)から、  
前記厚さ(46)よりも短い第1の深さ(48)だけ延在し、及び、

前記第2の窪み群(44)は前記ダイパッド(30)内に前記下側表面(36)から、  
前記厚さ(46)よりも短い第2の深さ(50)だけ延在する、

請求項1に記載のリードフレーム(22)。

【請求項3】

前記第1の窪み群(42)の前記第1の深さ(48)、及び前記第2の窪み群(44)の  
前記第2の深さ(50)は、ほぼ等しい、請求項2に記載のリードフレーム(22)。

【請求項4】

前記第1の深さ(48)及び前記第2の深さ(50)の各々は、前記厚さの約2分の1である、  
請求項2に記載のリードフレーム(22)。

【請求項5】

前記第1及び第2の窪み群(42, 44)は半円形に設けられる、請求項1に記載のリードフレーム(22)。

【請求項6】

前記第1及び第2の窪み群(42, 44)は、前記ダイパッド(30)の端面に、かつそれぞれの上側表面(34)及び下側表面(36)が前記側壁(38)と交差する位置に設けられる、請求項1に記載のリードフレーム(22)。

**【請求項 7】**

前記ダイパッド(30)内に前記下側表面(36)から延伸する前記第2の窪み群(44)は、前記ダイパッド(30)内に前記上側表面(34)から延伸する前記第1の窪み群(42)に対して前記側壁(38)に沿って偏位している、請求項1に記載のリードフレーム(22)。

**【請求項 8】**

前記ダイパッド(30)の材料部分(62)は、前記第1の窪み群(42)と前記下側表面(36)との間に延伸し、及び前記ダイパッド(30)の前記材料部分(62)は、前記第2の窪み群(44)と前記上側表面(34)との間に延伸している、請求項7に記載のリードフレーム(22)。

**【請求項 9】**

前記ダイパッド(30)の材料部分(62)は、前記第1の窪み群(42)の各々の間に延伸し、及び前記ダイパッド(30)の前記材料部分(62)は、前記第2の窪み群(44)の各々の間に延伸している、請求項1に記載のリードフレーム(22)。